



1. Zaprawa klejowa do przyklejania płyt styropianowych
- 2a. Elewacyjna płyta ze styropianu gr.16cm 0,036 [W/(m*K)]
- 2b. Elewacyjna płyta ze styropianu/styroduru min.gr.2cm 0,033[W/(m*K)]
3. Zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego
4. Podkład tynkarski gruntujący pod tynk silikonowy
5. Wyprawa tynkarska z tynku silikonowego
6. Listwa narożna z siatką
7. Taśma rozprężna
8. Silikonowa masa uszczelniająca.
9. Pianka uszczelniająca
10. Kołek do mocowanie termoizolacji

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MIKA Technika Grzewcza i Sanitarna Michał Mika
44-310 Radlin ul.Rymera 16
NIP 647-187-97-79



NAZWA RYSUNKU:

DETAL SYSTEMU DOCIEPLENIA
DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH

TEMAT:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
SŁUŻB KOMUNALNYCH MIASTA

PROJEKTANT:

PODPIS

INWESTOR:

MIASTO WODZISŁAW ŚL.
 44-300 Wodzisław Śl., ul. Bogumińska 4

OBIEKT:

Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl.
 44-300 Wodzisław Śl., ul. Marklowicka 21

LOKALIZACJA:

Wodzisław Śl. ul. Marklowicka 21
 DZIAŁKA NR: 2208/201

SKALA

--

NR RYS

D-01

DATA OPRAC.

04/2017